



2007年9月中間期 決算説明会

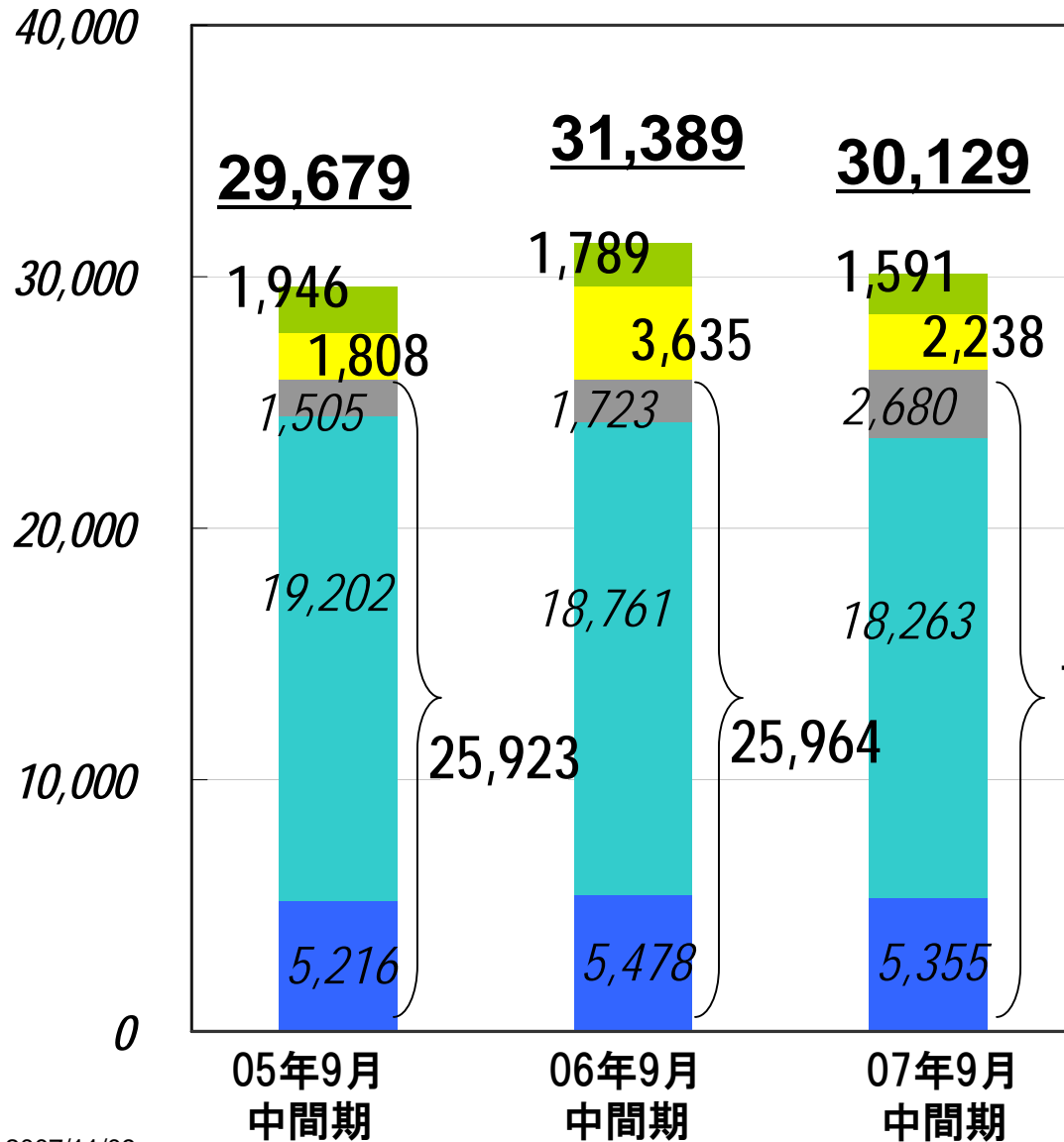
新日本無線株式会社



連結売上高の推移



(百万円)



<前年同期間比>

全体	△ 4.0 %
マイクロ波管 ・周辺機器	△ 11.0 %
マイクロ波 応用製品	△ 38.4 %
半導体	+ 1.3 %
半導体デバイス	+55.5 %
バイポーラ	△ 2.7 %
MOS	△ 2.2 %

中間連結損益計算書



(百万円)	06年9月中間	07年9月中間	増減率
売上高	31,389	30,129	△ 4.0%
売上原価	24,226	23,612	
販売費・一般管理費	5,837	5,744	
営業利益	1,324	772	△ 41.7%
営業外損益	△ 48	12	
経常利益	1,275	785	△ 38.4%
特別損益	△ 35	△ 46	
税金等調整前中間純利益	1,239	738	
中間純利益	824	342	△ 58.4%

マイクロ波関係の状況



(前年同期間比)

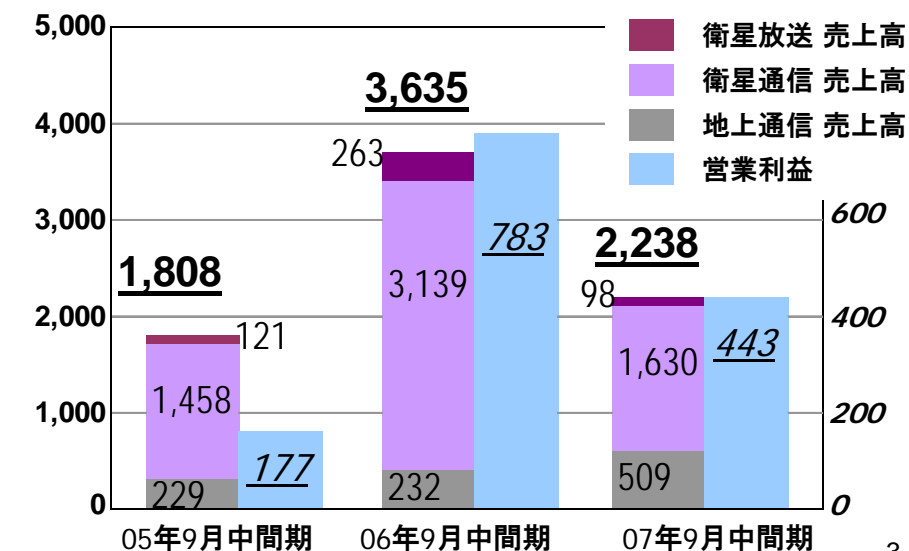
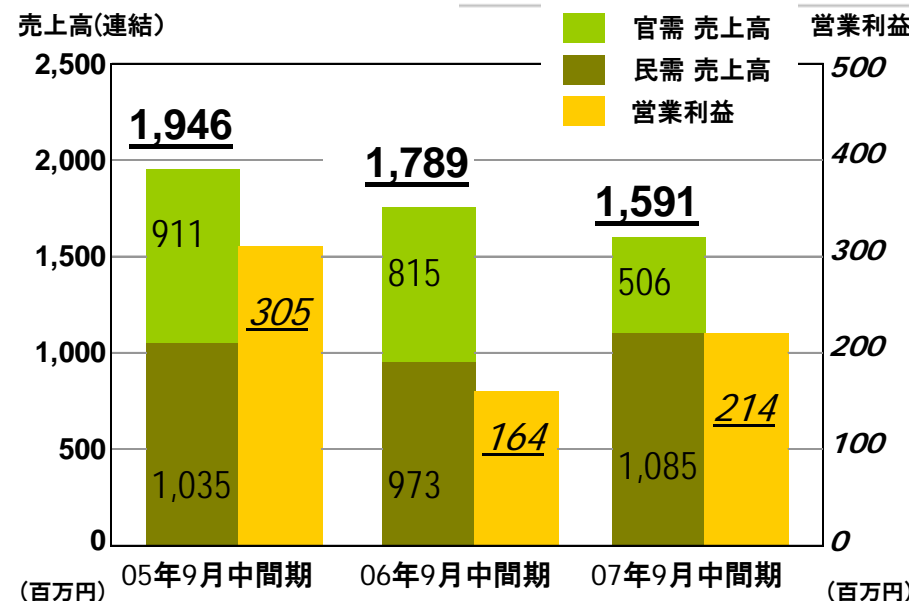
マイクロ波管・周辺機器 減収増益

官需	減	主要顧客の納期変更
民需	増	船舶レーダ市場活況

マイクロ波応用製品 減収減益

衛星通信	減	市場沈静化
地上通信	増	国内デジタル放送機器向け好調

※グラフ中の営業利益は配賦不能営業費用控除前の営業利益であります。



半導体の状況(1)

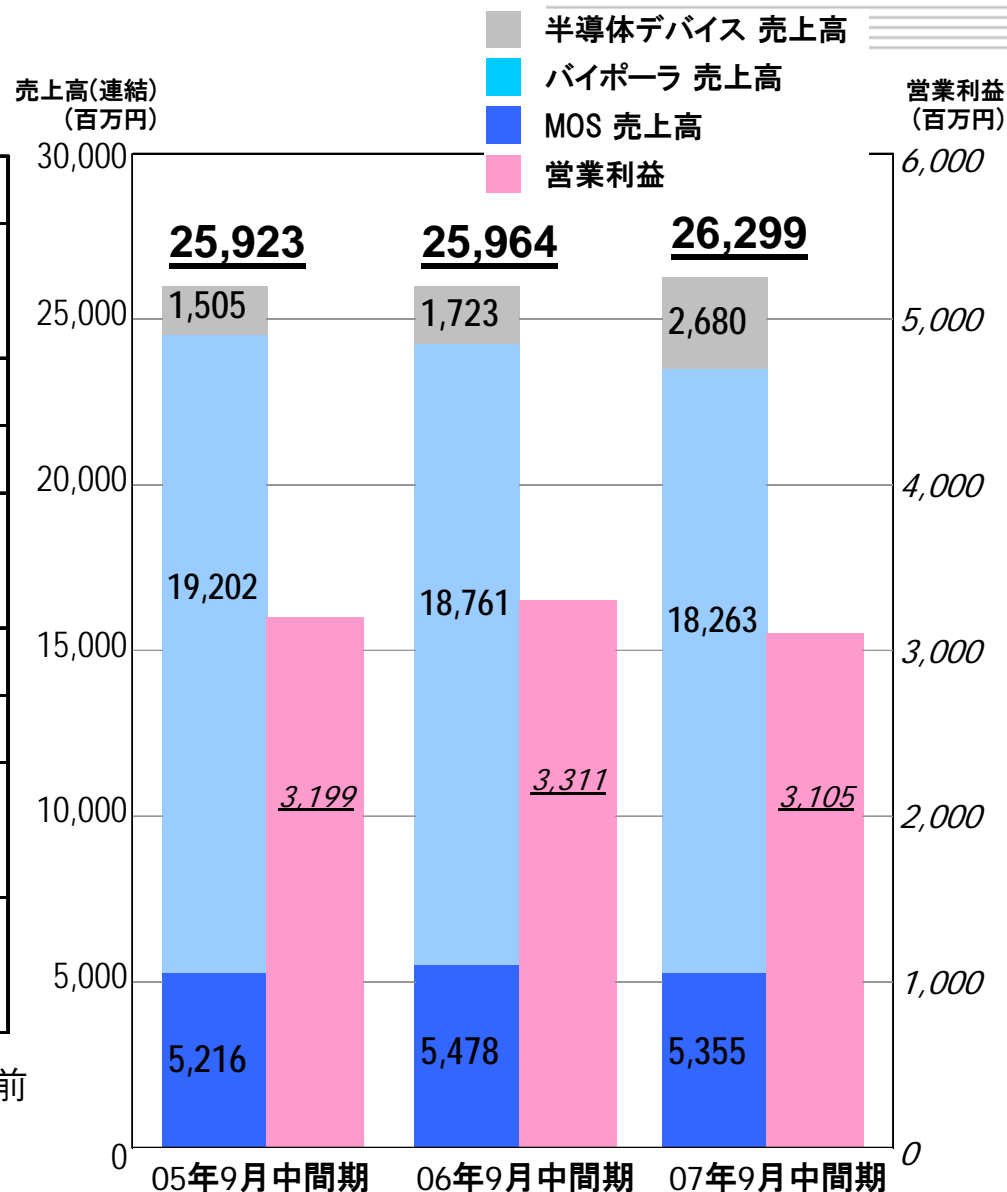


(前年同期間比)

半導体 増収減益

半導体デバイス	好調	+55.5 %
増	光半導体デバイス	+25.5 %
	マイクロ波デバイス(GaAs IC)	+69.2 %
バイポーラ製品	低調	△ 2.7 %
増	電源用IC	+10.2 %
減	オペアンプ・コンパレータ	△ 2.7 %
	オーディオ用IC	△ 7.6 %
	受託生産販売	△ 12.8 %
MOS製品	低調	△ 2.2 %
増	電源用IC	+51.7 %
	DSP	+16.5 %
減	オーディオ用IC	△ 17.3 %
	LCDドライバIC	△ 7.9 %

※グラフ中の営業利益は配賦不能営業費用控除前の営業利益であります。

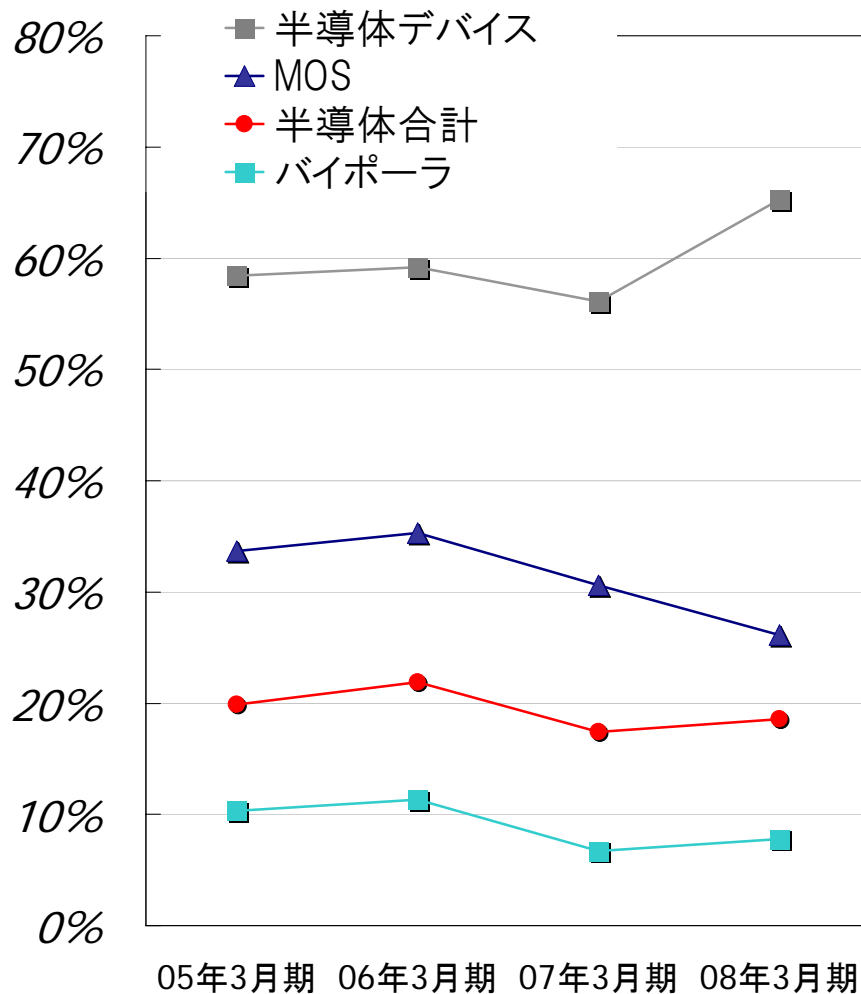


半導体の状況(2)

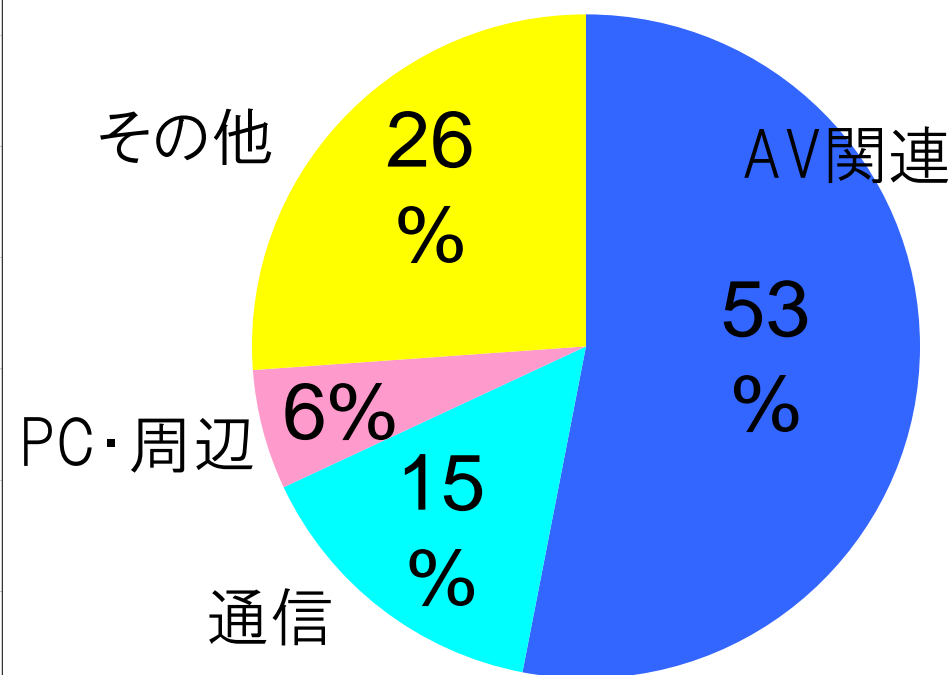


<個別>

半導体製品新製品販売比率



07年9月中間期販売分野別状況



連結設備投資実績等



(単位:百万円)

06年9月中間期 07年9月中間期

増減率

設備投資	1,821	1,591	△12.6%
------	--------------	--------------	---------------

減価償却費	1,740	2,070	19.0%
-------	--------------	--------------	--------------

試験研究開発費	2,991	3,087	3.2%
---------	--------------	--------------	-------------

連結貸借対照表

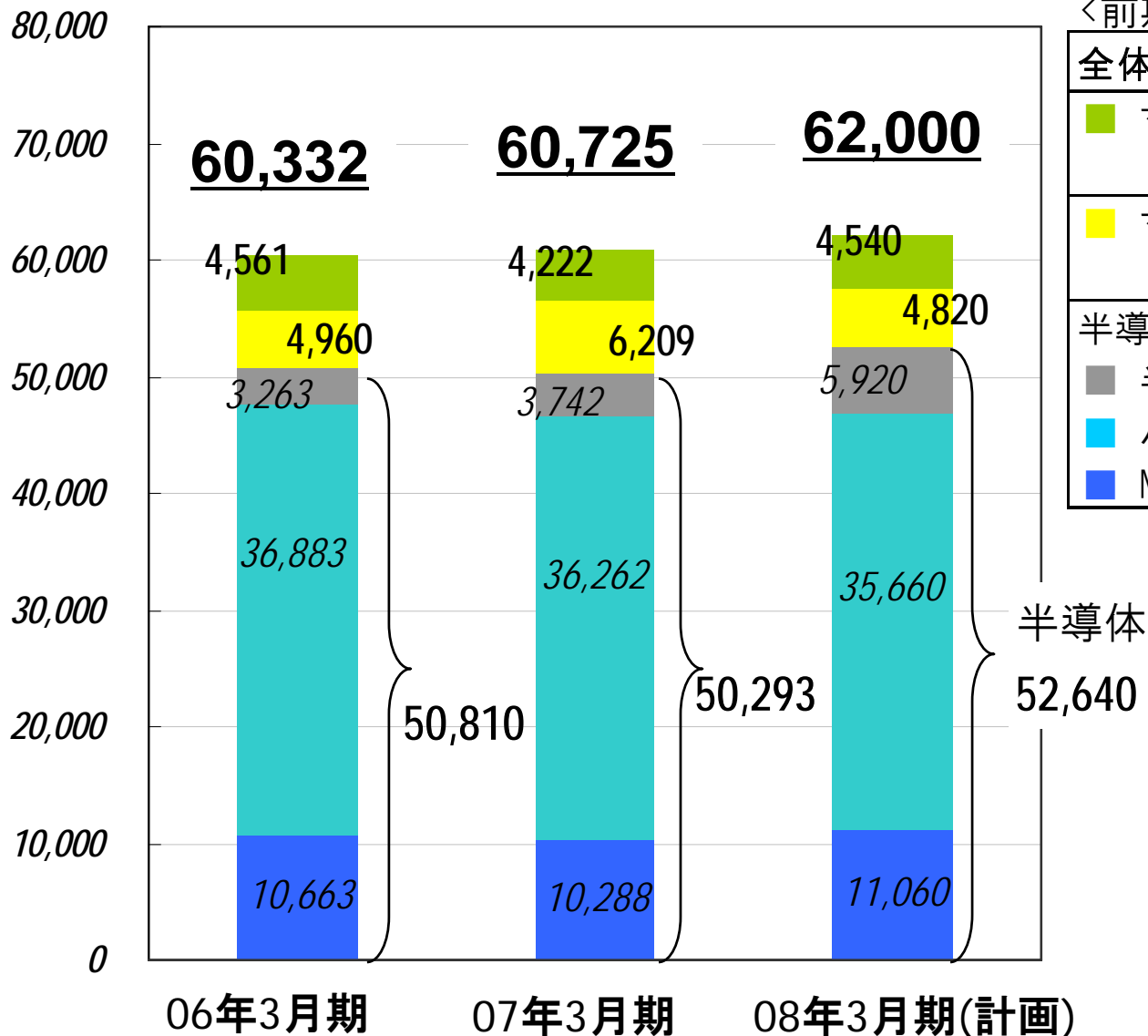


(単位:百万円)	07年3月期	07年9月中間期	増 減
資産 計	60,361	60,612	250
流動資産	37,913	38,192	279
固定資産	22,448	22,419	△28
有形	15,615	15,126	△488
無形	318	344	25
その他	6,514	6,948	434
負債 計	34,376	34,221	△154
流動負債	24,687	24,795	107
固定負債	9,688	9,425	△262
純資産 計	25,985	26,390	405

連結売上計画(事業部門別・全社)



(百万円)



<前期比>

全体	+2.1 %
■ マイクロ波管 ・周辺機器	+7.5 %
■ マイクロ波 応用製品	△ 22.4 %
半導体	+4.7 %
■ 半導体デバイス	+58.2 %
■ バイポーラ	△ 1.7 %
■ MOS	+7.5 %

2008年3月期 通期計画の概要



連結売上高 62,000百万円(前期比 2.1%増)

	前期比	
マイクロ波管	+7.5%	官需回復、民需増加
マイクロ波応用	△22.4%	衛星通信用コンポーネント製品売上減少 (従来の水準へ)
半導体	+4.7%	既存製品の拡販と新製品売上比率向上
半導体デバイス	+58.2%	GaAs IC、光半導体デバイス販売増
バイポーラ	△1.7%	電源用IC、モータ用IC販売増 受託生産販売減少
MOS	+7.5%	電源用IC、DSP、LCDドライバIC販売増

※計画上の為替レート: 115.00円/US\$

2008年3月期 連結損益計画



(単位:百万円)	07年3月期 実績	08年3月期 計画	増減率
売上高	60,725	62,000	2.1%
売上原価	47,295	48,400	
販売費・一般管理費	11,590	11,600	
営業利益	1,839	2,000	8.8%
営業外損益	△ 31	0	
経常利益	1,807	2,000	10.7%
特別損益	*933	△ 100	
税金等調整前当期純利益	2,740	1,900	
当期純利益	1,721	1,200	△ 30.3%

*2007年3月期において、当社の退職金及び退職年金制度変更による退職給付債務の減額分(993百万円)を特別利益に計上いたしました。

連結設備投資計画等



(単位:百万円)	07年3月期 実績	08年3月期 計画	増減率
設備投資	3,477	5,221	50.2%
減価償却費	3,885	4,978	28.1%
試験研究開発費	6,182	6,253	1.1%

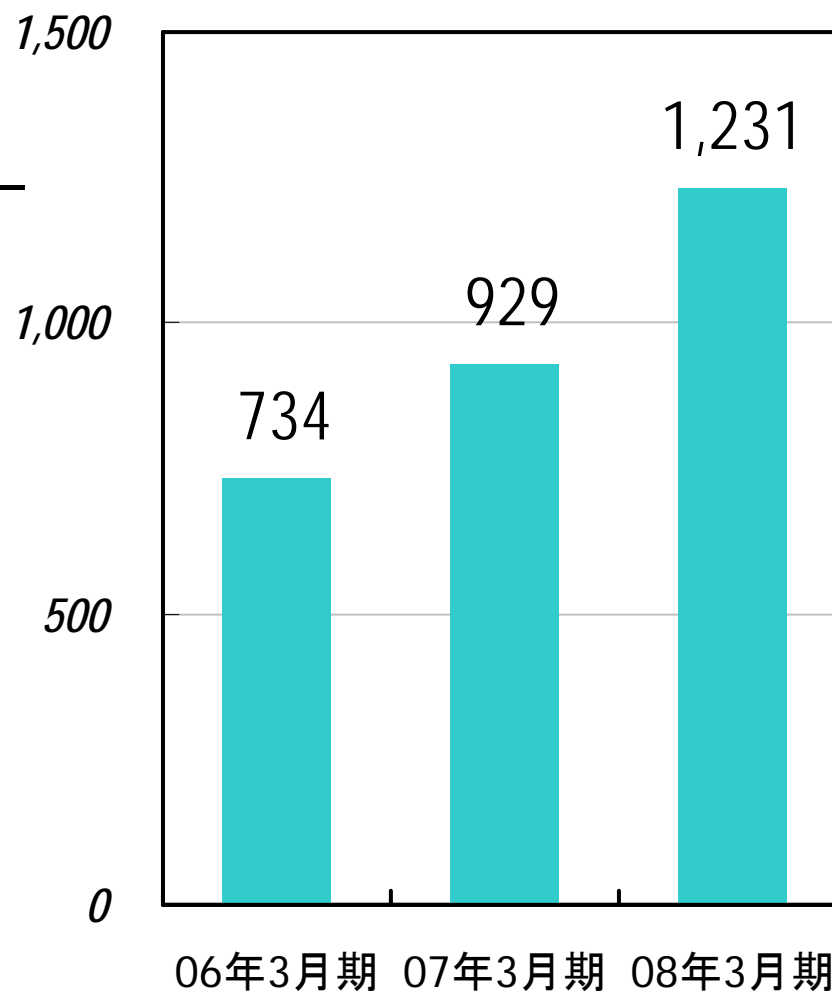
営業力の強化と拡充



顧客密着度の向上

- ・顧客近接の設計拠点活用
大阪、SINGAPOREデザインセンター
- ・華東・華北地域向け
営業支援拠点(上海)の活用
- ・子会社からの人材異動による
営業部門の強化

中国(華東・華北地域)における
(百万円) 半導体販売状況(個別)



競争力ある新製品の開発



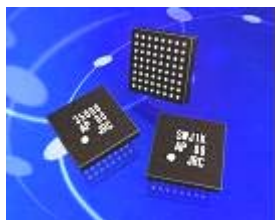
車 載：汎用ICに加え 専用ICも

産業機器：高精度・高速オペアンプ、高機能電源用IC

通 信：通信用IC（携帯電話等置忘れ防止用微弱無線LSI）

GaAs IC（携帯、PHS用に加え

ワンセグ用、GPS向け等製品拡大）



NJU35000

300MHz帯トランシーバIC

デジタルAV機器：デジタル信号処理IC（DSP）

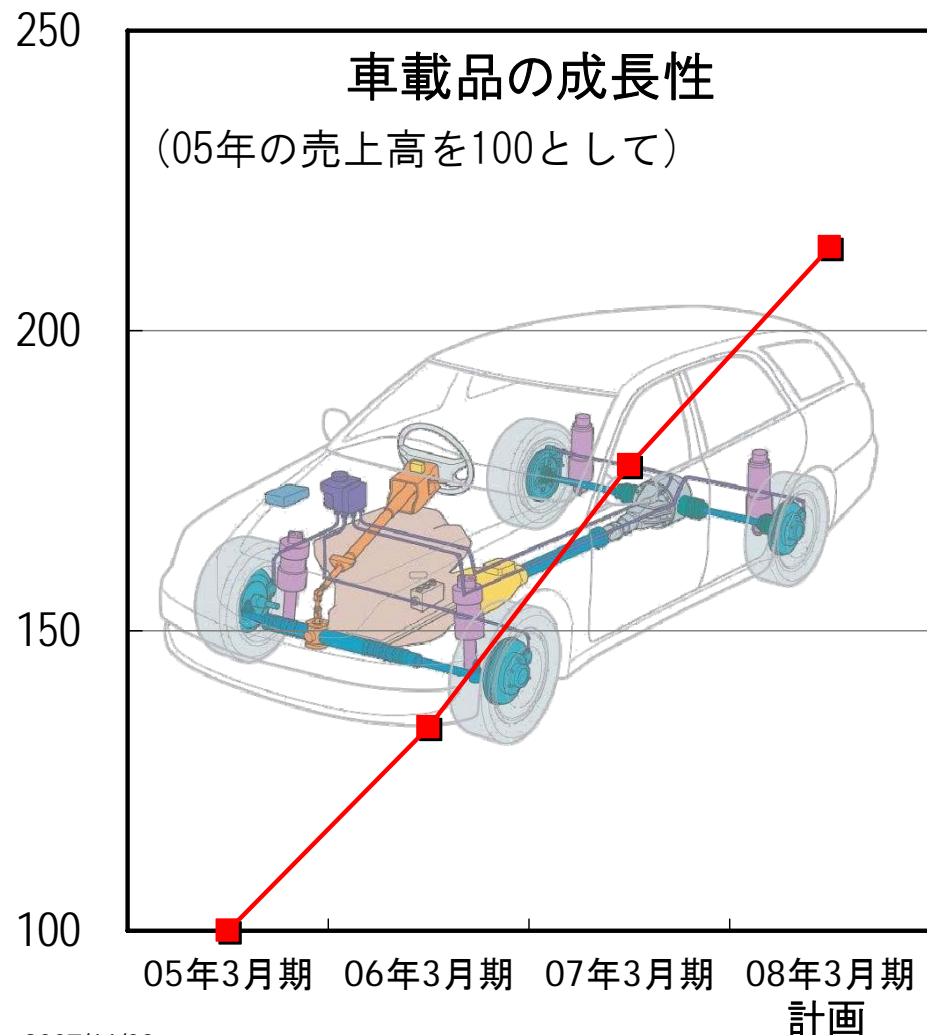
ハイエンドアナログオーディオ：世界トップクラスの

超高品質アンプ

車載用半導体製品



カーナビやカーオーディオに加えて自動車制御装置用等向け
オペアンプ・コンパレータ、電源用ICの拡販



- ・ISO/TS16949(自動車産業向け国際品質規格)認証取得
- ・国内自動車メーカーよりオペアンプのコアメーカーに認定される
- ・前工程から後工程までの国内一貫生産体制による高品質実現

電源用IC、GaAs IC

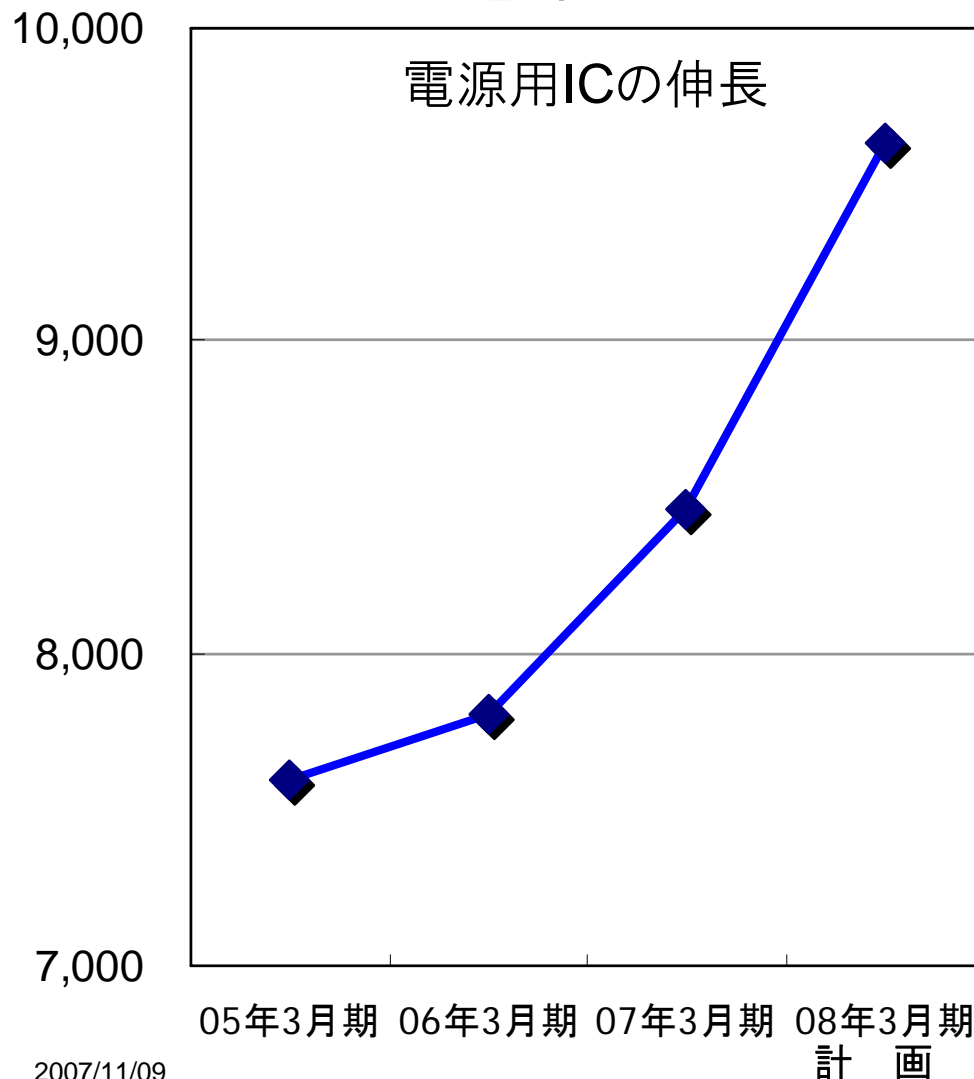


<個別>

(百万円)

電源用IC

GaAs IC



国内の全携帯電話機
メーカーに採用
海外の携帯電話機
メーカー採用増へ
アプリケーションの拡大
携帯電話機・PHSだけでなく、
ゲーム機 (Bluetooth) や GPS、
ワンセグ等向け

GPS機能付き携帯
端末向けに最適な
高利得/低雑音増
幅器(LNA)



NJG1130KA1

・当社独自のCSP(Chip Size Package)の展開

(07年9月中間期販売実績・個別)

FFP 150万個／月

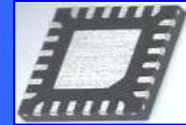
PCSP 50万個／月

更なる小型化・薄型化へ→

EQFN/ESON

ラインナップ

サイズ1～3mm角、
厚み0.4mm以下



・後工程子会社の役割分担の明確化、生産品種の整理

佐賀エレクトロニクス(株)

高付加価値製品

THAI NJR CO.,LTD.

低コスト指向品

(株)エヌ・ジェイ・アール秩父

オプト製品

グループ全体としての取り組み(1)



- ・生産子会社間のネットワーク強化
グループ各社の生産革新運動や
品質改善活動を水平展開



当社 川越製作所



(株)エヌ・ジェイ・アール福岡



佐賀エレクトロニクス(株)



THAI NJR CO.,LTD.



(株)エヌ・ジェイ・アール秩父

- ・品質経営の重視

- ・製品品質向上のみならず設計・販売・購買機能の向上も
社内教育・討議の徹底による品質重視ポリシーの浸透促進
- ・ISO9001, ISO/TS16949品質システムのグループ全体への展開

・ 環境経営の重視

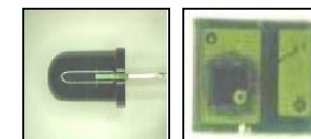
海外子会社も含めたグループ全体への展開を推進中

環境配慮製品の開発

製品設計の初期段階から環境保全に配慮

〈製品事例〉

照度センサー 有害物質がミウム不使用(RoHS指令対応品)
NJL7502R-L



衛星通信用VSATシステム用屋外送信機(3Wタイプ) *NJT5037*シリーズ
小型・軽量化・消費電力低減、部品点数約20%削減(RoHS指令対応品)



TV用DSP 薄型TVの音質改善を1チップ化、従来品の約20%消費電力低減、
NJU26120 ハロゲンフリーのパッケージ樹脂使用(RoHS指令対応品)



企業理念

社会の期待と顧客の期待の適合における中心的役割を
果たすことによって、健全な社会成長の一助となる

独創的「マイクロエレクトロニクスとマイクロウェーブ」技術を軸とした
最適部品の提供を通してコーポレートミッションを実現する

企業像

「高いクオリティを持つデバイスメーカー」として
世界的に評価されている

会社概要



創 立	1959年(昭和34年)9月	
	日本無線(株)より半導体、マイクロ波技術を継承した部品メーカーとして創立	
沿 革	1991年11月	株式公開
	2000年10月	東証第2部上場
	2002年9月	東証第1部上場
	2005年12月	親会社の異動 旧:日本無線(株) 新:日清紡績(株)
資 本 金	5,220百万円(日清紡績(株)出資比率 59.6%)	
従業員数	連結 3,198名(07年3月末現在)	
グループ会社 (連結子会社8社)	半導体製造会社(前工程): 1社(福岡)	
	半導体製造会社(後工程): 3社(佐賀・秩父・タイ)	
	半導体販売会社: 3社(国内・シンガポール・米国)	
	業務受託会社: 1社(国内)	
売 上 高	2007年3月期	49,497 百万円(連結 60,725百万円)
	2006年3月期	48,240 百万円(連結 60,332百万円)

本資料ご使用に当たり



- この資料に記載されている業績予想数値は、現時点で入手可能な情報をもとにした当社における推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。実際の業績は、様々な要因により、これらの予想数値とは大きく異なる場合があります。予めご承知の上、ご利用下さいますようお願い申し上げます。

本日は、ご清聴ありがとうございました。

新日本無線株式会社